

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2019-004

## 江苏捷捷微电子股份有限公司

### 关于公司获得发明专利的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、获得发明专利的情况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：

发明名称：一种带有七层对通隔离结构的可控硅芯片及其制备方法

专 利 号： ZL 2016 1 0142598.7

专利类型：发明专利

申请日期：2016 年 03 月 14 日

授 权 日：2019 年 01 月 08 日

本发明公开了一种带有七层对通隔离结构的可控硅芯片及其制备方法，包括阳极区 P1、N-型长基区、短基区 P2、N-型阴极区和正面的氧化膜、正面的门极金属电极、正面的阴极金属电极、背面的阳极金属电极、环形钝化沟槽及七层对通隔离结构的隔离环，七层对通隔离结构的隔离环是由从上到下的硼杂质区、硼铝混合杂质区、铝杂质区、铝-铝交叠杂质区、铝杂质区、硼铝混合杂质区、硼杂质区构成，七层对通隔离结构的隔离环沿垂直方向设于正面的氧化膜与背面的阳极金属电极之间并且环绕于阳极区 P1、N-型长基区、短基区 P2 四周，本发明扩散时间短、生产能耗低、效率高，硅片完整率高，隔离区表面的横向扩散少，隔离区宽度小，节约硅片面积。

上述发明专利的取得和运用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续

创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2019年1月29日